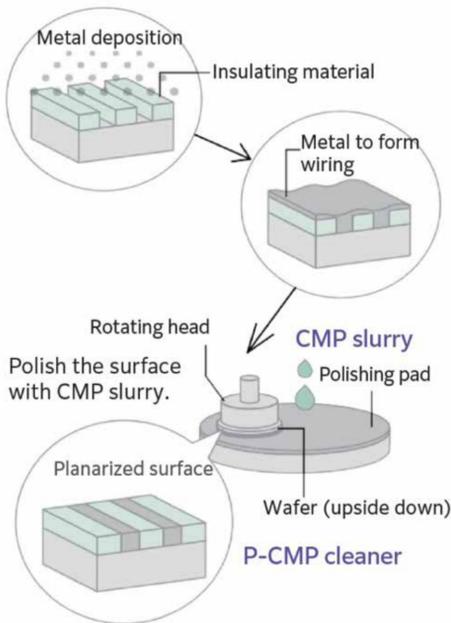


# 前工程から先端パッケージ分野までをカバーする CMP トータルソリューション

## CMP関連製品 テクノロジープラットフォーム



**FSL**

優れた平滑性を実現するコロイダルシリカベースのSTI向け (SoC・SoN・SoP) をはじめ、SiNやp-Si研磨用途等の多様なスラリーをラインアップ

**MSL**

Co配線のバルク/バリア用スラリー <世界シェアNo.1>  
W・Mo・Ru等の金属配線研磨用を開発中

**CSL**

Cu配線のバルク用スラリー (CSL) <世界シェアNo.1>  
新たなライナー (Mo・Ru・金属酸化物等) に適した処方を開発中

**BSL**

Cu配線のバリア (Ta・TaN・Co) 用スラリー <世界シェアNo.1>  
Ruライナーに対応。Mo・金属酸化物等のライナー向け処方を開発中

**PSL**

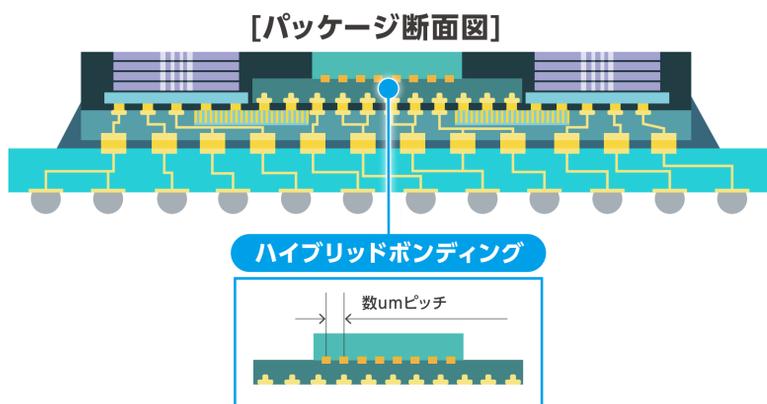
ウエハレベルパッケージ用 (BSPDN・ハイブリッドボンディング等)、  
RDL(ポリイミド・エポキシ) 及びガラス/樹脂パネル用スラリーをラインアップ

**P-CMP cleans**

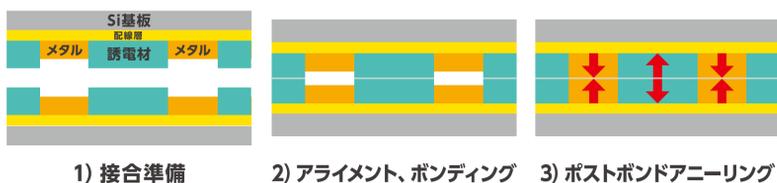
Cu配線用: CLEAN-100(酸性) & CCN900XC (アルカリ性) を展開  
W配線用: ロジック半導体の業界標準WCP-200<世界シェアNo.1>  
FEOL用: SiN・W・CSOD・CHM・酸化膜向けにFCN100Xを提案

## ハイブリッドボンディング用 CMP材料

前工程向けCu配線用スラリーをベースに添加剤・防食剤・砥粒の処方を最適化した先端パッケージ用スラリーを開発。  
**Cu接合面のばらつき制御を実現**

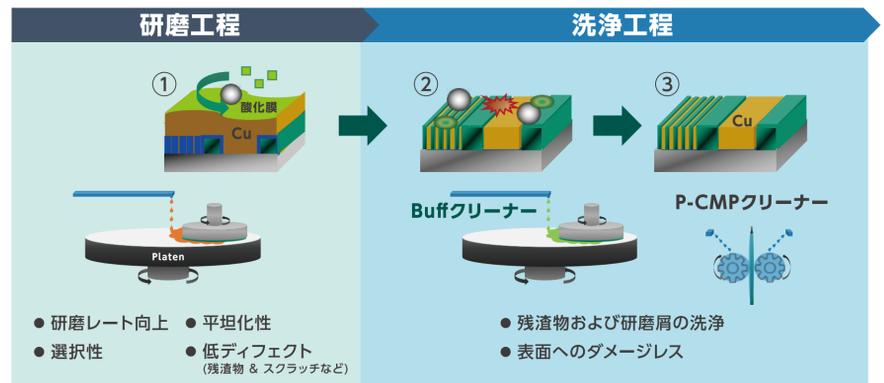


### ハイブリッドボンディング接合プロセスイメージ

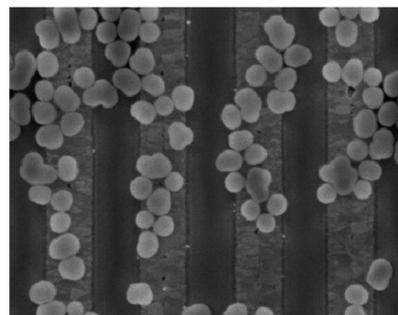


## Buffクリーナー

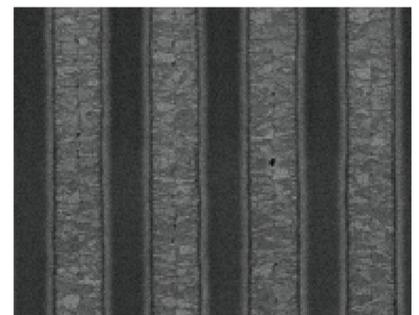
最先端ノードで課題となる「微小欠陥」の除去性を向上するため、プラテン上で洗浄を行う「Buffクリーナー」を新規開発



### Buffクリーナー洗浄なし



### Buffクリーナー洗浄あり



- 研磨レート向上
- 選択性
- 平坦化性
- 低ディフェクト (残渣物 & スクラッチなど)

- 残渣物および研磨屑の洗浄
- 表面へのダメージレス